公司代码：688603　　　　公司简称：天承科技

上海天承科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.406元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本124,724,524股，扣除公司回购专用证券账户中股份数438,802股后的股本数为124,285,722股，以此计算合计拟派发现金红利元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额17,474,572.51元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计17,474,572.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.16%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计17,474,572.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.16%。

2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份438,802股，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

母公司存在未弥补亏损

√适用　□不适用

截止报告期末，母公司存在未弥补亏损金额3,819,801.61元，未分配利润金额68,108,000.19元，不影响2025年度分红。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	天承科技	688603	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	童茂军（代任）	邹镕骏	苏志钦
联系地址	上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼	上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼	上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼
电话	021-59766069	021-59766069	021-59766069
传真	021-59766069	021-59766069	021-59766069
电子信箱	public@skychemcn.com	rongjun.zou@skychemcn.com	zhiqin.su@skychemcn.com

截至本年度报告披露前，公司副总经理、董事会秘书费维先生已于2026年4月15日离任，不再担任公司及子公司任何职务。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长、总经理童茂军先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2026-005）。

2、报告期公司主要业务简介

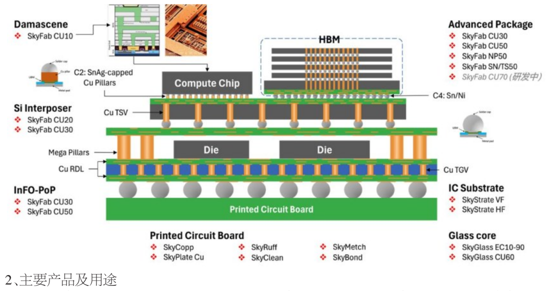
2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事印制线路板、封装载板和半导体先进封装所需要的专用功能性湿电子化学品的研发、生产和销售。随着制造技术发展进步和下游应用领域拓广，新工艺、新结构和新材料的引入进一步对功能性湿电子化学品提出了更新、更高的要求。

公司一直专注于化学沉积、电化学沉积及界面处理技术领域，研发团队深耕相关行业技术三十余年，是国内外相关领域最专业的领军企业之一。在电子电路领域，公司与国际竞争对手并驾齐驱，其产品与技术服务在行业中广受好评。尤其在聚酰亚胺、PET树脂、ABF材料表面的金属化技术方面，公司产品性能稳定，获得了主流封装载板厂和顶级OEM的认可。公司在半导体封装领域的再布线层、凸点和硅通孔电镀系列产品也得到了知名封装厂的肯定，性能达到国际先进水平。顺应高性能计算和人工智能的发展趋势，公司迅速投入玻璃通孔TGV金属化技术的研发，并已获得产业链的广泛认可。同时与顶级OEM企业建立了深入合作关系，共同推动产业化进程。

公司凭借强大的自主研发能力、持续的创新精神和全球化的战略布局，持续为客户提供高性能的功能性湿电子化学品以及优质的服务。公司将紧抓产业升级和国际化的新机遇，不断探索前沿工艺的融合发展，持续创新提升核心竞争力，打破行业垄断并持续提供创新的技术方案。



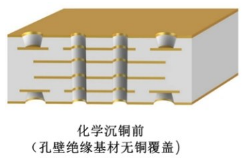
2、主要产品及用途

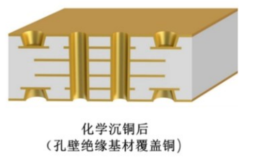
公司聚焦专用功能性湿电子化学品，公司主要产品包括化学沉铜专用化学品、电镀专用化学品、铜面处理专用化学品、先进封装专用化学品及其他专用化学品等，覆盖化学沉铜、电镀铜、电镀镍、电镀锡、棕化、粗化、退膜、闪蚀、化学沉锡等多个生产环节。其中化学沉铜和电镀铜工艺是电子电路制程中重要的环节，是实现电气互连的基础，直接影响电子设备的可靠性。

公司专用功能性湿电子化学品按照下游应用的制程工艺分为以下几类：

（1）化学沉铜专用化学品

化学沉铜是电子电路生产过程中重要的环节，系通过化学方法在不导电的介电材料表面沉积一层薄薄的导电铜层，为后续电镀铜提供导电种子层，是多层板之间电气互连的关键工艺流程。高质量的化学沉铜的效果是印制线路板、封装载板等导电性能的重要保证，进而保障了电路以及电子设备的可靠性。


化学沉铜前
（孔壁绝缘基材无铜覆盖）


化学沉铜后
（孔壁绝缘基材覆盖铜）

随着品质、技术和环保需求的驱动，中国大陆印制线路板厂商逐步采用水平沉铜工艺替代垂直沉铜工艺。与此同时，水平沉铜专用化学品成为沉铜制程使用的主流材料。

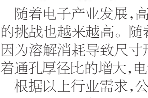
公司的水平沉铜专用化学品于2012年成功推向市场，经过十余年的发展，公司持续改善产品，目前已经发展出四大水平沉铜产品系列，能满足市场上不同电路板的生产需求。主要用于高端印制线路板、封装载板的生产。

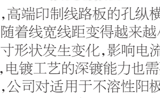
封装载板是芯片封装体的重要组成材料，主要作用为承载保护芯片以及连接上层芯片和下层电路板。针对新高端IC载板ABF膜如GL102和国产载板增层材料的特性，公司开发了兼容性更强的除胶剂、调整剂和低应力化学沉铜液等产品，随着公司载板沉铜专用化学品在材料兼容性和产品性能等方面的提升，公司在载板领域新开拓了苏州群策科技有限公司、江阴芯智联电子科技有限公司等客户。

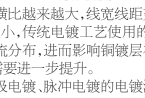
产品系列	产品特点	适用产品	目前主要客户
SkyCopp 365	1、盲孔处理能力强，可处理盲孔纵横比（孔径50-125?m）为1:1；2、适用现行的高频高速基材；3、单剂稳定剂，便于客户现场管控	适用于多层板、高频高速板、HDI、类载板、半导体测试板等	方正科技、崇达技术、景旺电子、信泰电子、博敏电子、广合科技、兴森科技等
SkyCopp 365SP	1、盲孔处理能力强，可处理盲孔纵横比（孔径50-125?m）为1:1—1:1.5；2、互连可靠性高，特定测试板严酷可靠性测试下（无铅Reflow 30次）内层连接测试与国际厂商同等水平。	适用于多层板、高频高速板、HDI、类载板、半导体测试板等	胜宏科技、深南电路、超毅电子、方正科技、世运电子、生益电子、景旺电子、中京电子等
SkyCopp 3651	产品不含镍，节能环保（市场上的水平沉铜药水一般含400ppm的镍离子）	适用于要求沉铜废水中不含镍的生产企业	定颖电子、博敏电子、兴森科技、景旺电子、崇达技术等
SkyCopp 3652	材料兼容性广泛，是一款低应力高贯孔能力产品，适用PI和BT材料	适用多层软板、软硬结合板以及载板	景旺电子、世一电子、宏锐兴等

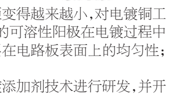
（2）电镀专用化学品

印制线路板在经过化学沉铜工艺之后，孔壁和铜面（SAP工艺后）上沉积上一层0.2-1?m的薄铜，使得不导电的孔壁产生了导电性，但是铜层的厚度还达不到电子元件信号传输和机械强度需要的厚度。导通孔通常要求孔内铜厚达到20?m以上，因此需要用电镀的方法把铜层加厚到需要的厚度。此外，高密度互连（HDI）、类载板等还要求盲孔完全填满铜以改善电气性能和导热性，有助于高频设计，便于设计叠孔和盘上孔，减少孔内空洞，降低传输信号损失，最终实现产品功能及质量的提高。


盲孔电镀填孔前


盲孔电镀填孔后


通孔电镀前


通孔电镀后

随着电子产业发展，高端印制线路板的孔纵横比越来越大，线宽线距变得越来越小，对电镀铜工艺的挑战也越来越高。随着线宽线距变得越来越小，传统电镀工艺使用的可溶性阳极在电镀过程中会因为溶解消耗导致尺寸形状发生变化，影响电流分布，进而影响铜镀层在电路板表面上的均匀性；随着通孔厚径比的增大，电镀工艺的深镀能力也需要进一步提升。

根据以上行业需求，公司对适用于不溶性阳极电镀、脉冲电镀的电镀添加剂技术进行研发，并开发出了以下主要产品系列、主要用于高端印制线路板、封装载板等的生产：

产品系列	主要特点	适用产品	目前主要应用客户
SkyPlate Cu658	1、适用不溶性阳极电镀，解决阳极保养问题，并减少铜成本；2、应用于水平线脉冲填孔，对盲孔填孔有显著优势；3、电镀速度快，完成填孔所需的面铜厚度低	适用于HDI、类载板电镀	超毅、方正科技等
SkyPlate VF6382	1、可应用在VCP或者龙门电镀设备，设备兼容性高；2、兼容可溶性阳极和不溶性析氧阳极，可应用于不溶性阳极直流填孔，填孔性能稳定；3、兼容通孔盲孔共镀	适用于HDI电镀	定颖电子、博敏电子、南亚电路、中京电子等
SkyPlate Cu6257	1、适用不溶性阳极VCP脉冲电镀，采用纯铜溶铜块技术，解决阳极保养问题，并减少铜成本；2、适用于通孔电镀，深镀能力好；3、镀层结晶均匀，应力低，延展性好，抗拉强度优良；4、相对于传统电镀，能应用较大的电流密度，提升产能。	适用于消费类电子产品，车板等	景旺电子等

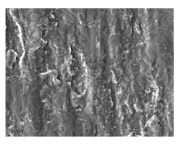
（3）铜面处理专用化学品

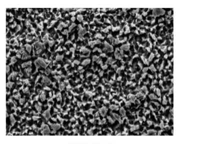
电子电路制造过程中需要对铜面进行贴膜、阻焊等工序，在这些工序之前，一般需要对铜面进行特殊处理，主要系通过改变铜表面形貌或化学成分以增强与树脂材料的结合力。

公司根据不同工序和不同电子电路对铜面处理的要求，开发出以下产品，主要用于高端印制线路板、封装载板、显示屏等的生产：

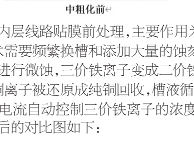
产品类别	应用环节	适用产品	主要客户
超粗化产品	防焊前处理	HDI、汽车板	奥特斯、定颖电子、方正科技、华通电脑、华通精密、景旺电子等
中粗化产品	防焊前处理；压膜前处理	5G通讯板、HDI	定颖电子、南亚电路、安泰诺等
再生微蚀产品	内层线路压膜前处理	通用大部分印刷线路板	明阳电路、中富电子等
碱性微蚀产品	表面处理	柔性电路板	景旺电子、精诚达、鹏鼎控股等

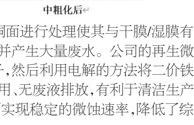
a、超粗化产品主要应用于防焊前处理，电路板的表面需要覆盖一层防焊油墨以防止焊接时短路，其中涉及铜与防焊油墨的结合，铜面必须经过适当处理，才会与防焊油墨有足够的结合力满足电路板的可靠性要求。公司产品处理前后的对比图如下：


超粗化前

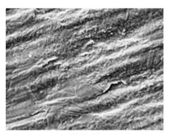

超粗化后

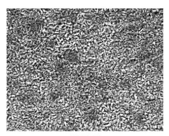
b、超粗化技术虽能满足铜与防焊油墨的结合力要求，但其粗糙度过高，不能满足5G等高频高速应用对信号完整性的要求。公司开发的中粗化产品，通过在铜面产生不规则蚀刻，在低微蚀量下使比表面积增加30-60%，同时能够控制表面峰谷之间的落差不至于过大，不仅可以满足5G信号对PIM值要求，还可以应用于贴膜前处理。公司产品处理前后的对比图如下：


中粗化前


中粗化后

c、微蚀产品用于内层线路贴膜前处理，主要作用为对铜面进行处理使其与干膜/湿膜有足够的结合力，传统的微蚀技术需要频繁换槽和添加大量的蚀刻液，并产生大量废水。公司的再生微蚀产品利用三价铁离子对铜面进行微蚀，三价铁离子变成二价铁离子，然后利用电解的方法将二价铁离子转化回三价铁离子，同时铜离子被还原成纯铜回收，槽液循环利用、无废液排放，有利于清洁生产。生产中还可以通过调节电解电流自动控制三价铁离子的浓度从而实现稳定的微蚀速率，降低了综合生产成本。公司产品处理前后的对比图如下：


微蚀前

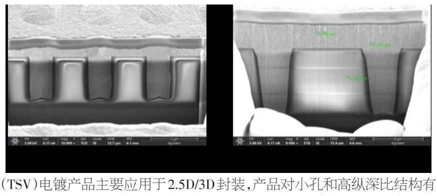

微蚀后

d、一般电子电路可以采用酸性微蚀产品进行表面处理，但对于某些特殊的材料，不适合采用酸性微蚀产品进行表面处理。如软板在做OSP时（有机可焊性保护剂，表面处理的一种方法），酸性微蚀药水对镀镍钢片的镍层存在一定程度的腐蚀，导致OSP后钢片发白，造成批量性的报废。公司开发出碱性微蚀产品，在碱性环境下对铜面微蚀清洁，不会腐蚀镀镍钢片镍层。

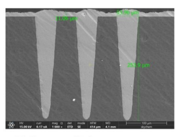
（4）半导体先进封装专用化学品

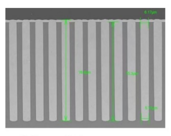
随着AI技术迅猛发展，极大增加了相关产业对高性能算力的需求，先进封装成为推动半导体发展的关键力量之一，公司围绕2.5D/3D先进封装、扇出型封装、玻璃基板等领域需求积极研发，目前公司已完成大马士革电镀铜、硅通孔（TSV）电镀铜、再布线层（RDL）电镀铜、凸点（bumping）电镀铜/镍/锡银和玻璃基板通孔TGV金属化等工艺所需电镀液产品的研发和技术储备，不断实现关键技术突破与产品应用，提速半导体制造关键材料及技术突破。

a、大马士革电镀产品主要用于半导体芯片BEOL的铜互连制造，其核心特点是通过电镀铜填充沟槽与孔后再经化学机械抛光（CMP）形成导线，从而规避铜难以干法刻蚀的难题，同时实现低电阻率和高深宽比结构的可靠填充。其主要效果图如下：



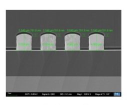
b、硅通孔（TSV）电镀产品主要应用于2.5D/3D封装，产品对小孔和高纵深比结构有优异的填充能力、具备面铜镀层薄，退火后表面凸起小、镀层杂质含量低、镀层应力低，延展性高和抗拉强度大等优点。其主要效果图如下：

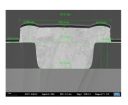

孔径50 μm，深度250 μm，AR～5

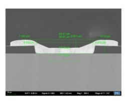

孔径6μm，深度75μm，AR～12

硅通孔（TSV）是HBM工艺中的核心工艺，其中TSV填孔镀铜是最核心、最难的工艺，对添加剂和设备的要求较高。随着TSV工艺趋向小孔径、高密度、大深宽比，制造过程容易产生内部温度、应力失配等问题，进而产生底部空洞、内部缝隙、填充缺失等典型缺陷，将会影响TSV工艺良率及成本。公司研发硅通孔电镀添加剂产品可对标国际品牌，目前正全力为头部客户提供技术领先的解决方案。

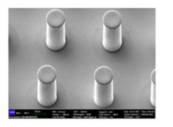
c、再布线层电镀铜产品主要应用于扇出型封装，产品具备优异的填孔和细线路能力，具有整片均匀性优异较低的镀层应力，高延展性和抗拉强度等优点。其主要效果图如下：

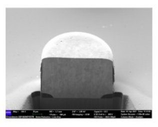

细线形貌


大孔形貌

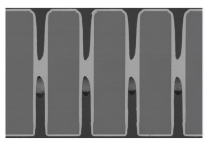

小孔形貌

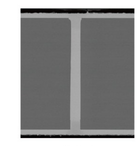
d、凸点电镀铜产品主要应用于倒装芯片封装，产品适用于高速电镀场景，电流密度可达20ASD、同时具备优异的高度均匀性和共面性、镀层杂质含量低、较低的镀层应力，高延展性和抗拉强度等优点。其主要效果图如下：


铜柱沉积电流：5ASD（10 μm）
+12ASD（110 μm）


铜柱沉积电流：6ASD（5 μm）
+14ASD（40 μm）

e、TGV电镀产品主要应用于先进封装中以玻璃基板为介质的孔电镀，产品适用于脉冲和直流电镀，具备填孔性能优异、较低的镀层应力，高延展性和抗拉强度、电镀后无晶体缺陷等优点。其主要效果图如下：


孔径40 μm，介厚400 μm，搭桥后


填孔后

公司在半导体封装领域的硅通孔电镀铜、再布线层电镀铜和凸点电镀系列产品得到了知名封装厂的肯定，性能达到国际先进水平。顺应高性能计算和人工智能的发展趋势，公司迅速投入玻璃基板通孔TGV金属化技术的研发，并已获得产业链的广泛认可。同时公司与京东方等顶级OEM企业建立了深入合作关系，共同推动产业化进程。此外，公司同步研发大马士革工艺、混合键合工艺等相关添加剂产品和应用技术，目前正努力推广中。

（5）其他专用化学品

公司的专用功能性湿电子化学品还包括触摸屏专用电子化学品、化学沉锡专用化学品、光阻去除剂、棕化专用化学品等，分别主要应用于金属网格沉铜工序、封装载板化学沉锡工序、退膜工序、棕化工序，目前在江苏软讯、南亚电路、景旺电子、奥特斯、信泰电子等知名电子电路厂商已量产应用。

2.2 主要经营模式

1、研发模式

公司主要服务于高端印制线路板、半导体互联等行业，电子类产品技术发展更新迭代较快，对于专用电子化学品的需求也不断变化。为应对相关行业技术的不断更新，解决客户的诉求，及时为市场提供匹配新技术、新材料、新工艺的优质产品，公司始终重视研发工作，拥有独立的研发部门和研发团队，将研发工作作为公司发展的重要支撑。

公司研发模式为自主研发，立足于自主研发、自主创新，拥有一套独立完善的研发体系。公司研发工作由研发中心负责，下设技术委员会、专家组、平台研发和产品研发。公司已形成了完善的研发流程，研发方向以行业技术发展和应用需求为基础，研发内容主要包括新产品和技术研发以及现有产品的持续优化。

公司产品的研发主要包括两个阶段：

（1）实验室研发测试阶段

公司研发人员通过对应用材料特性、基础化学品性质的研究，对基础配方进行设计、选材和配比，从烧杯测试到中试线的反复验证，形成功能性湿电子化学品的基础配方。

（2）产线技术开发阶段

为公司选择合适的具有代表性的客户产线进行技术开发，并针对不同客户生产线实际情况，如喷流压力、喷流量、喷流角度、负载量等以及复杂多样的材料及电子电路产品结构设计(比如孔大小、密度、分布等)，对配方进行进一步验证和优化，并匹配最合适的应用参数的范围，包括各个工序中电子化学品的浓度、配比、温度、压力等，最终确定电子化学品的标准配方及相配套的工艺应用参数。

2、采购模式

公司以"源头采购与向经销商采购相结合"的方式进行原材料的采购，对于贵金属等金额较大、使用量较大的原材料公司主要向生产厂家采购；使用量不大的原材料主要通过经销商采购。

公司制定了严格的供应商选择程序。公司通常选择行业内具有较高知名度的供应商进行合作，对于有合作意向的供应商，公司会进一步对其经营资质、生产能力、质量及稳定性、工艺水平、供货及时性、价格等多方面进行评估；评估通过后方可纳入供应商名录，建立采购合作关系。

对于确认合作关系的供应商，公司进行跟踪管理，对供应商交货及时性及品质合格率进行评价，对于评价不合格的供应商，公司将进行降级处理，减少或者停止向该供应商采购产品。

3、生产模式

公司采用"以销定产、订单驱动、合理库存、合理排产"的生产模式，专用功能性湿电子化学品在下游厂商生产过程中属于耗用稳定的产品，生产部门结合客户的订单以及市场部门的销售预测利用ERP系统自动制定生产计划，根据生产计划自动下发生产任务并开展生产作业。

4、销售模式

公司主要采取直销的销售方式，经销的比例较低。公司和客户的销售结算方式主要包括包线销售和单价销售。公司根据客户的生产工艺需求，提出解决方案，并制定产品组合方案，同时，公司委派技术服务工程师到客户生产线进行技术支持等相关售后服务，必要时由技术委员会的技术专家提供问题解决方案和支持。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业发展阶段

功能性湿电子化学品系印制线路板、封装基板、半导体先进封装生产制作中的必备原材料，电子电路、半导体先进封装的生产制造过程中的化学沉积、电化学沉积、界面处理等众多关键工序均需要使用大量专用电子化学品。根据Prismark最新报告统计2025年全球PCB产值约为851.52亿美元，同比增长约15.8%，产值增速显著高于面积增速，反映PCB行业产品结构正在持续调整，高端产品占比正逐步提高，其中18层及以上多层板、HDI增速明显高于行业水平，主要得益于AI算力、新一代通讯技术和人工智能及新能源汽车等下游领域呈高景气，带动PCB产业相关产品需求保持较高增长。受益于半导体封装领域的需求提升，封装基板保持稳健增长。中长期层面，PCB产业延续高频高速、高精密度、高集成化等发展趋势，18层及以上的高多层板、HDI板、封装基板未来五年复合增速预计保持相对较高水平。从区域分布看未来五年全球各区域PCB产业仍呈增长态势其中，中国大陆地区复合增长率为7.7%。

国内功能性湿电子化学品行业起步较晚，国内企业起初主要通过技术难度较低的洗槽剂、消泡剂、蚀刻、剥膜、褪锡等产品进入市场，后续逐步开发棕化、沉铜、电镀、化学镍金等重要工艺所用的功能性湿电子化学品。在普通PCB双面板和多层板专用电子化学品方面，国内厂商占有一定的市场份额。对于高频高速板、HDI、软硬结合板、类载板、半导体测试板、载板、半导体等高端PCB、半导体先进封装使用的功能性湿电子化学品，国内整体的技术水平相比国际先进水平还有一定差距。由于功能性湿电子化学品的性能高低能够在一定程度上决定高端PCB、半导体先进封装产品在集成性、导通性、信号传输等特性和功能上的优劣，因此高端PCB、半导体先进封装厂商对于功能性湿电子化学品供应的选择较为谨慎，其中沉铜和电镀添加剂尤为明显，因此高端PCB、半导体先进封装专用功能性湿电子化学品长时间被欧美、日本等地品牌所占领。

随着中国大陆电子电路产业的发展壮大和国产化替代的需求扩大，近几年来中国大陆电子电路功能性湿电子化学品企业持续加大对研发的投入，建立研发中心，同时招聘高水平技术人才，生产技术水平得到了有效的提升。同时，部分企业针对下游厂商的需求进行定制化开发，实现对产品配方创新和改良，将产品打入下游厂商，逐渐打破外资企业对高端PCB、半导体先进封装专用功能性湿电子化学品的垄断。

（2）行业基本特点

国外功能性湿电子化学品发展起步较早，国际知名功能性湿电子化学品制造商掌握研发的核心技术，品牌知名度高，市场占有率高，具备较强的先发优势。我国功能性湿电子化学品发展起步较晚，国内企业在生产规模、技术和品牌等方面竞争力较弱，高端功能性湿电子化学品国产化需求十分迫切。当前，在全球集成电路、人工智能、大算力、新能源汽车等产业产能加速向中国转移的背景下，从产品交期、供应链保障、成本管控及技术支持等多方面考虑，原材料进口替代的需求十分强烈，境内功能性湿电子化学品企业迎来了重大的发展机遇。

（3）行业主要技术门槛

电子电路功能性湿电子化学品行业具有较高的技术门槛，具体体现为以下方面：

①专业综合性较强：电子电路专用电子化学品的配方设计和调整系材料学、电化学、有机化学、物理、化工工艺等多个学科知识的综合应用，需要技术专家对行业技术有敏锐判断，并经过多次反复测试才能形成成熟的产品。

②下游技术需求较复杂：电子电路的种类较多，相应对专用电子化学品提出不同的技术需求。特别对于高端PCB（含封装载板）和半导体先进封装，近年来高端PCB材料种类和型号不断增加，包括各类高频高速基材、软板PI膜、载板的ABF材料和BT材料等，因此需要根据材料的特性开发出兼容性更高的专用电子化学品。与此同时，高端PCB产品结构的升级对专用电子化学品也提出新的技术需求，比如高多层设计的通孔纵横比不断提高，对专用电子化学品的灌孔能力提出更高的要求；多阶盲孔和任意层互联的结构设计，对专用电子化学品在盲孔的润湿性提出更高的要求。因此高端PCB使用的专用电子化学品配方开发具有更高的技术壁垒。

③功能性湿电子化学品在实际应用中，应用工艺的参数比如药水浓度、药水搭配组合、生产设备运行参数（如运行速率、温度，泵频率）等影响电子化学品的应用效果，行业内企业需要经过长时间的应用积累才能形成成熟的应用经验，从而形成较高的技术与经验壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

由于功能性湿电子化学品领域具有较高的技术门槛，因此高端电子电路板制造使用的专用功能性湿电子化学品长期被安美特、陶氏杜邦、麦德美乐思等国际巨头所垄断。受中美贸易摩擦等因素影响，国内高科技企业积极推动上游供应链核心原材料"国产化"，以实现"自主可控"，保障自身产业链安全。国内企业转向国产核心原材料促使上游供应链企业加强技术研发，不断改革创新，加快国产化进程步伐，这也为国内专用电子化学品企业提供了良好的发展机遇。

公司作为一家专业从事功能性湿电子化学品研发及产业化的高新技术企业，通过近三十年的研究发展，在产业升级和国际化新机遇的背景下，天承科技将凭借自身的研发、产品、服务、口碑等优势进一步提升销售规模与市场份额，持续探索前沿工艺的融合发展，致力于成为一家国内功能性湿电子化学品的领军企业。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，公司研发并推出了半导体先进封装相关的功能性湿电子化学品，其中，大马士革、TSV、RDL、bumping、TGV等先进封装电镀添加剂等产品已推向下游测试验证，获得了知名封装厂的肯定，性能达到国际先进水平。公司投资建设集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目的新项目，旨在建设半导体集成电路领域电子化学品的生产基地。公司目前正大力推动相关先进封装电镀液及晶圆级电镀液投向市场的进度。

当前，在全球集成电路、人工智能、大算力、新能源汽车等产业加速发展、加速竞争的背景下，从产品交期、供应链保障、成本管控及技术支持等多方面考虑，原材料进口替代的需求十分强烈，境内功能性湿电子化学品企业迎来了重大的发展机遇。公司作为一家积累了近三十年并专注于高端功能性湿电子化学品研发及产业化的高新技术企业，不断开发高端产品将有助于打破国外巨头在相关领域的垄断，填补国内相关材料技术空白，加速国产替代，增强我国高端功能性湿电子化学品的全球竞争力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,353,632,476.66	1,242,601,122.09	8.94	1,170,731,269.42
归属于上市公司股东的净资产	1,195,344,696.73	1,121,806,995.89	6.56	1,097,127,653.75
营业收入	470,964,851.77	380,670,972.91	23.72	338,928,877.29
利润总额	100,620,939.84	87,087,737.61	15.54	67,600,805.66
归属于上市公司股东的净利润	86,679,137.43	74,679,913.48	16.07	58,572,302.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,426,882.99	62,111,324.27	19.83	54,890,351.60
经营活动产生的现金流量净额	61,039,781.01	71,096,999.52	-14.15	62,164,790.39
加权平均净资产收益率(%)	7.53	6.80	增加0.73个百分点	8.23
基本每股收益（元／股）	0.69	0.60	15.00	0.79
稀释每股收益（元／股）	0.69	0.60	15.00	0.79
研发投入占营业收入的比例(%)	7.30	7.35	减少0.05个百分点	6.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	101,527,715.09	111,622,180.11	120,855,395.00	136,959,561.57
归属于上市公司股东的净利润	18,973,252.65	17,760,307.49	23,275,595.85	26,669,981.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,825,549.20	14,914,683.66	20,454,942.25	22,231,707.88
经营活动产生的现金流量净额	8,442,781.48	20,395,088.34	5,636,397.65	26,565,513.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	5,759
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	4,694
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天承化工有限公司	11,208,236	20,866,346	16.73	20,866,346	无	0	境外法人
上海道添电子科技有限公司	10,980,909	20,443,131	16.39	20,443,131	无	0	境内非国有法人
童茂军	9,941,826	18,508,673	14.84	18,508,673	无	0	境内自然人
上海青骐企业管理合伙企业（有限合伙）	7,535,098	14,028,074	11.25	14,028,074	无	0	其他
上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙）	2,067,279	3,951,190	3.17	3,587,501	无	0	其他
基本养老保险基金二零零一组合	2,311,184	2,311,184	1.85	0	无	0	其他
深圳市前海睿兴投资管理有限公司－宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）	348,566	2,095,836	1.68	0	无	0	其他
青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融富田三期私募投资基金	1,195,786	1,195,786	0.96	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金	1,101,597	1,101,597	0.88	0	无	0	其他
青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融帛汇10号私募证券投资基金	1,025,616	1,025,616	0.82	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述的前十名股东中：股东上海道添电子有限公司为实际控制人童茂军控制的企业，除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用　□不适用

单位：股

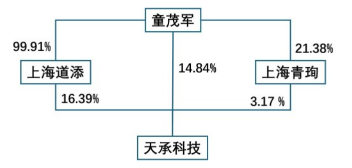
序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	天承化工有限公司	20,866,346	0	20,866,346	16.73	11,208,236	不适用
2	上海道添电子科技有限公司	20,443,131	0	20,443,131	16.39	10,980,909	不适用
3	童茂军	18,508,673	0	18,508,673	14.84	9,941,826	不适用
4	上海青骐企业管理合伙企业（有限合伙）	14,028,074	0	14,028,074	11.25	7,535,098	不适用
5	上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙）	3,951,190	0	3,951,190	3.17	2,067,279	不适用
6	基本养老保险基金二零零一组合	2,311,184	0	2,311,184	1.85	2,311,184	不适用
7	深圳市前海睿兴投资管理有限公司－宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,095,836	0	2,095,836	1.68	348,566	不适用
8	青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融富田三期私募投资基金	1,195,786	0	1,195,786	0.96	1,195,786	不适用
9	中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金	1,101,597	0	1,101,597	0.88	1,101,597	不适用
10	青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融帛汇10号私募证券投资基金	1,025,616	0	1,025,616	0.82	1,025,616	不适用
合计	/	85,527,433	0	85,527,433	/	/	/

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度内，公司始终聚焦核心业务发展，坚持以高质量发展为战略目标，全面提升经营管理水平，推动企业稳步迈向更高台阶。报告期内，公司在持续强化市场拓展能力的同时，积极巩固现有市场优势，通过优化产品销售结构，不断提升高价值产品的销售占比，进一步夯实市场竞争力。同时，公司持续加大产品研发投入，专注于技术创新与突破，依托丰富的产品矩阵和全面的服务解决方案，有效满足多元化市场需求，为公司核心竞争力赋能。此外，公司深入推进精细化管理，通过优化资源配置、引入智能制造、强化成本控制和提升运营效率，实现了降本增效的目标，为进一步提升盈利能力奠定了坚实基础。通过上述多项举措的协同推进，公司营业收入和净利润实现了稳步增长，为企业高质量、可持续发展奠定了坚实基础，并持续为股东与社会创造更大价值。报告期内，公司实现营业总收入470,964,851.77元，同比增长23.72%；实现归属于母公司所有者的净利润86,679,137.43元，同比增长16.07%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润74,426,882.99元，同比增长19.83%。报告期内，公司总体经营情况如下：

1、紧抓材料国产替代和产业升级机遇，塑造添加剂国内第一品牌

报告期内，公司紧抓国产替代以及客户产品的升级机遇，积极推动如电镀添加剂系列产品的推广和销售，持续优化整体的产品销售结构。随着高附加值产品销售占比的提升，公司的盈利能力也稳步增强。在原有高端印制线路板、封装载板领域的添加剂品类中，公司的目标是持续打造具备国际竞争力和影响力的国内第一品牌。

2、积极布局海外市场，提升公司海外市场竞争力

报告期内，面对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局的变化，公司积极应对并部署发展战略。一方面，公司设立了海外架构，完成了泰国子公司设立，为海外的技术交流、市场拓展搭建舞台；一方面，公司报告期内已完成铺设营销渠道、泰国建设工厂准备，建立对东南亚地区的供应能力。此外，公司根据实际情况，及时调整募集资金投向，与公司出海的战略形成犄角之势，为打造具备国际竞争力的功能性湿电子化学品品牌打下基础。

3、不断加大研发投入，持续创新和丰富产品矩阵

报告期内，公司继续以化学沉铜、电镀等电子电路核心制程所需产品为重点和导向，同时努力开发其在更多领域的应用。不断丰富产品种类，扩大产销规模，抓住产业升级和国产化机遇，推动研发成果加速落地和商业化，形成公司业绩新的增长点。报告期内，公司研发投入34,364,313.02元，占营业收入的7.30%。截至2025年12月31日，公司共计获得现行有效的专利授权76项，其中发明专利57项，实用新型19项，另获得软件著作权2项。报告期内，公司新增专利5项，其中发明专利4项。

4、开拓新板块，谋求新增长，打造平台型半导体核心材料供应商

报告期内，公司积极引入国内优秀人才组建团队并设立集成电路事业部，将产品拓展至半导体先进封装以及显示面板等领域的功能性湿电子化学品，同时公司完成将总部从广东省迁至上海市浦东新区，并在当地设立独立的子公司进行事业部的发展。公司落地上海后，正加速转型成为一家集成电路领域核心材料研发、销售的平台型上市公司，为国内集成电路的补链强链提供全力支持。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688603　　证券简称：天承科技　　公告编号：2026-013

上海天承科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金9,100.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.71%。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	79,938.28万元
募集资金净额	70,737.90万元
超募资金金额	30,629.05万元
募集资金到账时间	2023年7月4日

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份的数量为14,534,232股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元。扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《广东天承科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-008）《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）及《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035），公司首次公开发行股票募集资金拟投入以下项目的建设：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	备注
1	年产30000吨专项电子材料电子化学品项目	24,943.11	17,052.70	——
2	金山工厂升级改造项目	12,400.57	8,360.17	——
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	——
4	集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目	5,000.00	3,000.00	超募资金
	合计	57,343.68	43,108.85	——

二、超募资金使用安排

超募资金金额	30,629.05万元
前次已使用金额	3,000.00万元
本次使用用途及金额	□在建项目，项目名称，____万元 □新项目，项目名称，____万元 □回购注销，____万元 ☑其他，永久补充流动资金，9,100.00万元

（一）超募资金前期使用情况

公司于2023年8月30日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币3,000万元用于投资建设集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目。

截至2025年12月31日，公司已经使用了3,000万元超募资金用于集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目。上述超募资金投入金额不包含使用理财收益及利息投入的金额。

（二）本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为30,629.05万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为9,100.00万元，占超募资金总额的比例为29.71%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明中关于超募资金使用的新旧规则适用的相关要求。

（三）相关承诺及说明

公司本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途的情形，满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：

1、公司用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；

2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

三、适用的审议程序及保荐机构意见

（一）审批程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次计划使用超募资金9,100.00万元永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规的规定。公司使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次计划使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688603　　证券简称：天承科技　　公告编号：2026-006

上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议通知于2026年4月23日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司2025年年度报告公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司利润分配的预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司对现行的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，有利于进一步完善公司治理结构，建立健全科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性与创造性。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了本议案，因全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬情况，并认为2026年度高级管理人员薪酬方案能够进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事童茂军、刘江波回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案无需提交公司股东会审议。董事会将在2025年年度股东会上对2026年度公司高级管理人员薪酬方案进行说明。

（六）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司日常生产经营与业务发展的资金需要，提高资金营运效率，优化债务结构并降低综合融资成本，进一步增强公司应对市场竞争的抗风险能力，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币100,000万元（含本数）的综合授信。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性与高效性，在综合考虑北京德皓国际的执业质量及对公司业务了解程度的基础上，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟续聘北京德皓国际为2026年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度，面对复杂的宏观经济环境与日益激烈的行业竞争，公司管理层在董事会的战略指导下，紧紧围绕年度经营目标稳步推进各项工作。报告期内，公司始终以技术创新为核心、以客户需求为导向，在募投项目建设、高端产品研发、生产运营提效及内部管理深化等方面持续发力，有效保障了主营业务的稳健发展，较好地完成了各项经营指标。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东高度负责的态度，勤勉履职、科学决策。报告期内，董事会切实履行各项法定职权，全面贯彻落实股东会决议，持续完善公司治理体系，不断提升规范运作水平，有效推动了公司的高质量发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

2025年度，公司独立董事认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥自身的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》（杨振国、蒋薇薇、石建宾）。

本议案无需提交公司股东会审议。独立董事将在2025年年度股东会进行述职。

（十二）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

公司董事会审计委员会严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度要求，勤勉尽责、规范履职，切实履行监督审查、沟通协调等各项工作职责，有效发挥了专业决策支撑与风险监督作用。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，按时完成公司2025年度审计相关工作，出具的报告客观、完整、清晰，切实履行了审计机构应尽的职责，确保了审计工作的质量和独立性。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，充分发挥独立监督职能，对会计师事务所和注册会计师的独立性、资质条件、执业能力等进行了审查，在年审期间与注册会计师进行了充分的联络沟通，密切关注审计计划、人员和时间等资源配备情况、初审意见情况、项目质量复核情况，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会作为公司治理层对会计师事务所的监督职责。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司独立董事2025年度独立性自查情况的议案》

公司董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对其独立性的相关要求。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途的情形，满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2026年第一季度报告公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月20日14:00，以现场会议与网络投票相结合的方式，召开公司2025年年度股东会。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会
2026年4月28日